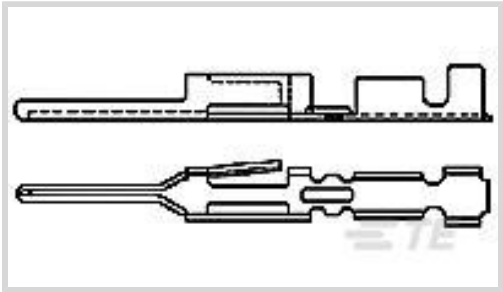




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板连接器端子



端子类型: 插针

连接器系统: 线到板

端子接触部电镀材料: 锡

Wire Size: .12 – .35 mm²

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

端子接触部长度	10.2 mm[.402 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1.524 – 3.048 µm[60 – 120 µin]
端子接合区域电镀材料厚度	1.524 – 3.048 µm[60 – 120 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡
端子方向	直式
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体內的端子定位器类型	卡口
带导线绝缘	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	1 – 1.6 mm[.039 – .062 in]
Wire Size	.12 – .35 mm²

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 85 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	15000
封装方法	Reel

其他

注释	需使用小型压接模具进行端接
----	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



客户还购买了



TE 产品编号173645-3
070 MLC TAB CONT 20-16 GOLD



TE 产品编号169481-1
HANDTOOL (MOD-4)



TE 产品编号36964
SPLICE,CE 22-14



TE 产品编号163996-1
02P.CIS FEMALE ASSY



TE 产品编号3-282830-0
EUROSTYLE TB SPECIAL INK STAMP

文档

产品图纸
LONG COSI CIS PIN
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_164333-1_H.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_164333-1_H.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_164333-1_H.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
应用规格
英文版本
CIS Crimp Snap-In Receptacle Contact
英文版本